

# 关于高温熔化焊料的使用说明

--针对 RoHS 豁免条款 7(a)--

经过十几年的功率半导体行业的蓬勃发展，现代无铅焊锡材料技术还不能在芯片装片中作为一种嵌入式解决方案来替代含铅高温熔点焊料。深圳虹美功率半导体有限公司（简称“公司”）持续致力于含铅高温焊料的解决方案，并与材料供应商和设备供应商密切合作，但目前还没有可取代的嵌入式无铅焊料。

根据目前的情况，公司无法预测用无铅焊料替代含铅焊料的日期。这个转换过程要花费大量的时间当有更多可行的焊接结果时公司将发布更新。

深圳虹美功率半导体有限公司